

# 光回路実装技術(OPT)研究会 第79回OPT公開研究会

主催：光回路実装技術研究会  
協賛：IEEE EPS Japan Chapter

## ◆公開研究会のご案内

光回路実装技術(OPT)研究会では、2022年度第79回OPT公開研究会を開催します。

今回は、「シリコンフォトニクスの実装技術」を特集テーマとして、シリコンフォトニクスに関する製造技術、シリコンフォトニクス用の光源技術と光接続技術に関して、海外を含む著名な講師の方々からご講演をいただきます。

開催日時 2022年10月28日(金) 13:00～17:00

開催方式 ハイブリッド研究会 (オンサイト(回路会館)とZoom Meeting)

開催場所： 回路会館地下1F会議室

東京都杉並区西荻北3-12-2

<https://jiep.or.jp/about/access.html>

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:00～13:05

ご挨拶 光回路実装技術委員会 委員長 長瀬 亮(千葉工業大学)

13:05～13:55

「GF Fotonix – Global FoundriesのSilicon Photonics技術と今後の展開」  
グローバルファウンドリーズジャパン 上田 真 氏



<要旨>グローバルファウンドリーズ社は「GF Fotonix」の提供を開始した。特徴は、シリコンフォトニクスとモノリシックにRFCMOSトランジスタを集積すること、フリップチップ実装が可能な平行ファイバーのセルフアラインアタッチ技術である。これらを用いることで、高性能な光電変換の消費電力を半減させ、エコシステムのOSATを用いた量産規模を容易に拡大することが可能である。2023年に製品化される51Tスイッチシステムへ展開されることを見込んでいる。

13:55～14:45

「シリコンフォトニクス用量子ドットレーザ」  
株式会社 QDレーザ 大西 裕 氏



<要旨>量子ドットレーザは低消費電力動作、高温動作可能な光源として注目されている。シリコンフォトニクスを用いた光インターコネクットの光源として、高温特性および戻り光耐性に優れた波長1300nm帯の量子ドットレーザとその適用例について紹介する。

(休憩 15分)

15:00～15:50

「光電コパッケージ用シリコンフォトニクス内蔵パッケージ基板の研究開発」  
国立研究開発法人産業技術総合研究所 乗木 暁博 氏



<要旨>我々は次世代の光電コパッケージの実現に向け、光電変換機能を有するパッケージ基板の研究開発を行っている。本講演ではマイクロミラーやポリマー導波路といった要素技術や、試作基板の光特性評価結果について概説する。

15:50 ~ 16:40

「Enabling next Generation Photonic Integration and Packaging Solutions with Photonic Wire Bonding」  
Vanguard Automation GmbH Sebastian Skacel 氏



<要旨> With the growth of photonic integrated circuits comes the need to innovate quickly. And this innovation acceleration is made possible by the creation of Photonic Wire Bonding. Photonic Wire Bonding creates low-loss, 3D free-form connections between optical components. Built on advanced nano-print technology, Photonic Wire Bonding is inherently automatable and provides a high degree of design flexibility.

16:40~17:00

パネルディスカッション

コーディネーター: 平 洋一、天野 建

パネリスト: 上田 真 氏、大西 裕 氏、乗木 暁博 氏、Sebastian Skacel 氏

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

## 参加要項

定 員 回路会館 30名、Web 150名 (共に先着申込順)

参加費(消費税込み。現地参加、Web参加共に同額。)

JIEP正会員、賛助会員、IEEE EPS会員:5,000円、 JIEP学生会員、IEEE EPS学生会員:無料、

JIEP名誉会員:無料、 JIEPシニア会員:1,000円

賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:10,000円、非会員学生(資料あり):1,000円、非会員学生(資料なし):無料

## 注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。  
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
- ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
- ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。

\* キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

**下記から参加申し込みをお願いします。**

**会員/賛助/非会員の方**

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

E-mail: opt-kennkyukai@jiejep.or.jp

(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)